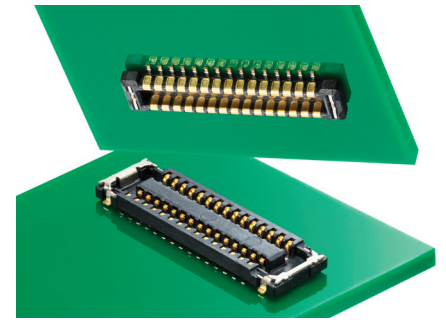


SlimStack Board-to-Boardコネクター 0.40mmピッチ B8シリーズ

molex

0.40mmピッチ、嵌合高さ0.80mmのSlimStack B8シリーズは、CleanPointコンタクト設計により、過酷な使用環境においても異物（ほこり・ごみなど）を除去し、粗雑な取り扱いにもコネクターへのダメージを防ぐ堅牢コネクターです。

今後もその価値と複雑さを増してゆく各種デバイス設計において、コストを要するリワークやリペアを避けるためには、接続の安定性が求められます。どのようなデバイスでも、コネクターへの信頼性が極めて重要となっています。フレキシブルケーブルと基板の接続に使用するジャンパーの製造工程では、接点部へのフラックスやほこり・ごみの付着により接触の信頼性が損なわれることがあります。モレックスのB8シリーズではCleanPointコンタクト設計を採用。傾斜を付けることによりフラックスその他異物を除去し、電気信号の安定性を高めています。

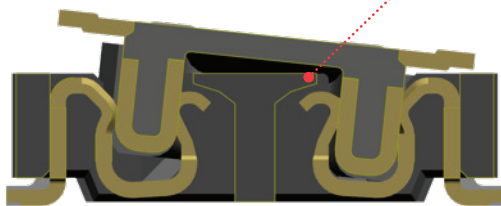


特徴・利点

ハウジング上壁

ハウジングの上壁（ストッパー）が「ジッパーリング」や斜め抜去時に生じる端子の浮きを防止

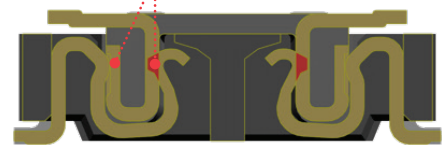
斜め抜去（ジッパーリング） ハウジング上壁



デュアルコンタクト設計

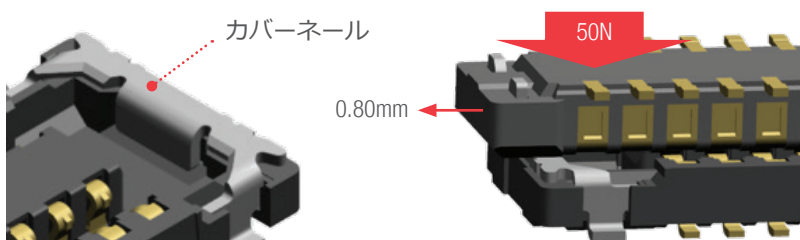
モレックスのSlimStack B8シリーズにはデュアルコンタクト設計を採用。落下衝撃による瞬断の軽減、粗雑な取り扱いにも接触安定性を維持

デュアルコンタクト



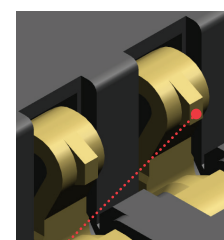
カバーネール

ブラインド嵌合や斜め抜去（ジッパーリング）時の損傷からハウジングを保護。
モレックスのB8コネクターに対する嵌合試験では0.80mmの嵌合位置ずれにおいても最大50Nまで耐えることが可能



SlimStack B8 CleanPointコンタクト

モレックスのCleanPointコンタクト設計は優れた電氣的信頼性を実現すると同時にフラックス等の異物からもコンタクトを保護



アプリケーション

モバイル機器

- スマートフォン
- タブレットPC
- ウェアラブル機器
- ポータブルオーディオ
- ポータブルナビゲーション機器



スマートフォン



ウェアラブル機器



ポータブルナビゲーション

SlimStack Board-to-Boardコネクター 0.40mmピッチ B8シリーズ

molex

仕様

参考情報

梱包形態: エンボステープ、リール
寸法単位: mm
RoHS: 準拠
ハロゲンフリー: ローハロゲン

電气的性能

最大定格電圧: 50V
最大定格電流: 0.3A (1極あたり)
接触抵抗: 80 mΩ以下
耐電圧: 250V AC
絶縁抵抗: 100 MΩ以上

機械的性能

耐久挿抜回数: 最大30回

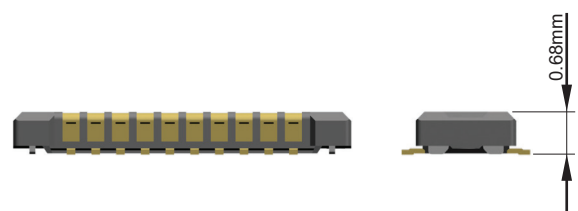
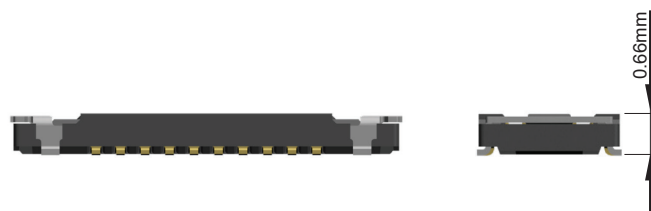
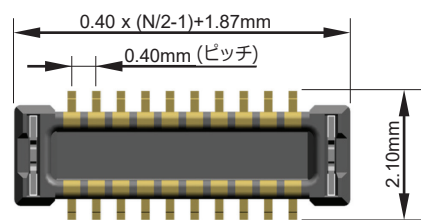
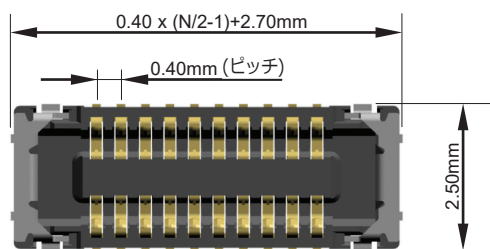
材質

ハウジング: LCP、UL 94V-0、黒
コンタクト: 銅合金
メッキ:
コンタクトエリア: 金
半田付け部: 金
下地メッキ: ニッケル
使用温度範囲: -40 ~ +85°C

寸法

* 詳細寸法は製品図面を参照してください。

N: 極数



オーダーインフォメーション

オーダー番号		詳細	嵌合高さ (mm)	嵌合幅 (mm)	極数
リセプタクル	プラグ				
505550-**-20	505551-**-20	ハウジングエッジ内にネイルエッジが付いたコネクター	0.80	2.50	10, 16, 20, 24, 30, 34, 40, 50

** : 極数

www.molex.com/link/slimstack.html
www.japanese.molex.com/link/slimstack.html

Molexは、アメリカ合衆国におけるMolex, LLCの登録商標であり、他の国々でも登録されている場合があります。ここに表示されているその他すべての商標も該当する所有者に帰属します。